

Qualcomm анонсировала проведение ежегодного Snapdragon Summit с 23 по 25 сентября, где покажут новый чип Snapdragon 8 Gen 2 Elite. Но конкурент MediaTek может опередить Qualcomm и представить свой флагманский процессор Dimensity 9500 уже 22 сентября, пишут СМИ.

Чип Dimensity 9500 будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P и получит восьмиядерный CPU на основе последнего дизайна ARM Cortex-X9. Geekbench показал, что основной ядро Travis X930 разгоняется до 3,23 ГГц, три ядра Alto — до 3,03 ГГц и четыре ядра Gelas — до 2,23 ГГц.

Графический процессор Mali-G1-Ultra MC12 работает на частоте 1 ГГц и поддерживает игры с трассировкой лучей со скоростью более 100 кадров в секунду. Новый чип также получит улучшенный NPU с производительностью 100 TOPS.

По данным инсайдера Digital Chat Station, первыми смартфонами на базе Dimensity 9500 станут vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro.